



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091117002

2009 年 11 月 20 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP nFBGAパッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	■Initial notice (Plan)	□Final notice
変更概要	Design/Specification	□Design □Electrical □Mechanical
	Wafer Fab	□Site □Process □Material
	Wafer Bump	□Site □Process □Material
	■Assembly	□Site □Process ■Material
	Test	□Site □Process
	Others	□Packing/Shipping/Labeling □ -
変更内容	ASP nFBGA パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行：Au(金)線 ボンディングワイア 変更後：Cu(銅)線 ボンディングワイア	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2010 年 2 月下旬の出荷予定より予定しています。 (サンプル出荷は 12 月下旬を予定しています。)	
品質認定試験	■計画	□終了
製品表示	■変更無し	□変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) nFBGAパッケージ 一部製品について、現行 Au (金) 線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、ボンディングワイアの機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為に、これに替えて、Cu (銅) 線 ボンディングワイアへ移行する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

ボンディングワイア

現行

Au (金) 線

変更後

Cu (銅) 線

理由: 機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

対象製品リスト

対象製品名				
C6421SURFVOZWT4	DM355SZCEA216	M355ZCE270QUADRANT	M6444ZWTTIME	TMS320C6424ZWT7
C6421SURFVOZWT4B	DM355ZCE216DETEG	M355ZCE270WPGSF	M6446AZWTBESTA	TMS320C6424ZWT1
C6421SURFVOZWT5	DM355ZCE216ECH	M6435CZWTSLG	M6446AZWTBJSF	TMS320DH6435ZWT6
C6421SURFVOZWT5B	DM6437ZWT6-101IMAGE	M6441AZWTBJSF	M6446AZWTHAIER	TMS320DH6443ZWT
C6421SURFVOZWT6	DM6441ZWTARCH	M6441AZWTHAIERIN	M6446AZWTHAIERIN	TMS320DH6446ZWT
C6421SURFVOZWT6B	DM6441ZWTARCL	M6441AZWTHHTSPHI	M6446AZWTHISENSE	TMS320DM335CZCE135
C6424SURFVDZWT4	DM6441ZWTBEK	M6441AZWTIFLYTECH	M6446AZWTPAV	TMS320DM335CZCE216
C6424SURFVDZWT4B	DM6441ZWTMSN	M6441AZWTMICRO	M6446AZWTPM	TMS320DM335CZCE270
C6424SURFVDZWT5	DM6443ADB6C3126MP	M6441AZWTPM	M6446AZWTSKYWORTH	TMS320DM335CZCE135
C6424SURFVDZWT5B	DM6443DB6C3125MP	M6441AZWTSEED	M6446AZWTTONGLI	TMS320DM335CZCE216
C6424SURFVDZWT6	DM6446AAB6C4130VD	M6441PMPZWTING	M6446ZWTAVMEAWOX	TMS320DM335CZCE270
C6424SURFVDZWT6B	DM6446ANB6C2127VC	M6441PNDZWTING	M6446ZWTAVMEHIMEDI	TMS320DM335CZCEA135
C6424SURFVOZWT4	DM6446APB6C6128ED	M6441PTVZWTING	M6446ZWTAVMEMOTO	TMS320DM335CZCEA216
C6424SURFVOZWT4B	DM6446AZWTKEDACOM	M6441ZWTHAIERIN	M6446ZWTHAIERIN	TMS320DM350HAZWK
C6424SURFVOZWT5	DM6446EB6C2110VS	M6441ZWTSREU	M6446ZWTHAERSF	TMS320DM350HZWK
C6424SURFVOZWT5B	DM6446GB6C0121MV	M6443AZWTBJSF	M6446ZWTHISENSE	TMS320DM350HZWKR
C6424SURFVOZWT6	DM6446HB6C0114VC	M6443AZWTHAIER	M6446ZWTJ1UZHOU	TMS320DM350LAZWK
C6424SURFVOZWT6B	DM64461B6C0107VS	M6443AZWTKAITIAN	M6446ZWTRINCOTEX	TMS320DM350LZWK
DM335SZCE135	DM64461B6C4112VS	M6443AZWTPM	M6446ZWTSKYWOTH	TMS320DM350ULZWK
DM335SZCE216	DM6446LB6C3108VS	M6443ZWTARTIES	M6446ZWTSREU	TMS320DM355CZCE135
DM335SZCE270	DM6446LB6C3109VS	M6443ZWTAMI	M6446ZWTSSTYLE	TMS320DM355CZCE216
DM335ZCE135TYCO	DM6446M1CD1C2104SC	M6443ZWTAVMEAWOX	M6446ZWTSYS	TMS320DM355CZCE270
DM350HZWK-ACM	DM6446MLTD1C2105ST	M6443ZWTAVMEHIMEDI	M6446ZWTVERSMO	TMS320DM355CZCE27J
DM350HZWK-KD17	DM6446NB6C5123NP	M6443ZWTAVMEKONKA	M6446ZWTVTAILYN	TMS320DM355CZCEA13
DM350HZWK-KD53	DM6446RB6C6122VP	M6443ZWTAVMEMEDIAE	M6447ZWTAVMEMOTO	TMS320DM355CZCEA21
DM350HZWKMINTON	DM6446RB6C6124VP	M6443ZWTAVMEYUXING	M6447ZWTAWX	TMS320DM355ZCE135
DM350LZWKAB	DM6446SB6C6117MD	M6443ZWTAVMEZTE	M6447ZWTLEADTEK	TMS320DM355ZCE216
DM350LZWK-ACM	DM6446ZB6C3111VP	M6443ZWTING	M6447ZWTTIME	TMS320DM355ZCE270
DM350LZWKA0	DM644NECED1C2102VC	M6443ZWTJET	SN3490586	TMS320DM355ZCEA135
DM350LZWKMINTON	F761516ZAV	M6443ZWTVERISMO	TMS320C6421ZWT4	TMS320DM355ZCEA216
DM350LZWKPHIL	M350ZWKDPFING	M6443ZWTVTAILYN	TMS320C6421ZWT5	TMS320DM357ZWT
DM350UHZWKHD	M355ZCE216BSTSP	M6443ZWTWNC	TMS320C6421ZWT6	TMS320DM6431ZWT3
DM350ULZWKMINTON	M355ZCE216CCTV	M64444ZWTRAVM	TMS320C6421ZWT7	TMS320MED355ZCE216
DM355SZCE135	M355ZCE216JABIL	M6444AZWTAIRIES	TMS320C6421ZWT1	
DM355SZCE216	M355ZCE216NEXTAR	M6444AZWTAMI	TMS320C6424ZWT4	
DM355SZCE270	M355ZCE216WPGSF	M6444ZWTAMI	TMS320C6424ZWT5	
DM355SZCEA135	M355ZCE270BSTSP	M6444ZWTAVM	TMS320C6424ZWT6	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 15 日	終了	2010 年 1 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	X6567G4NN0ZWK		X6680AZGUR	
Wafer Fab:	DMOS6		UMC12A	
Wafer Technology:	1218C027.05		1218C027.05	
Assembly Site:	TIPI		TIPI	
Package Code/Pins:	ZWK/293		ZGU/144	
Mount Compound:	Ablebond 84-3MV		Ablebond 84-3MV	
Mold Compound:	Shinetsu KMC-3580T		Shinetsu KMC-284T	
Substrate:	UMTC/Ibiden		Ibiden	
Substrate Composition:	Laminate		Laminate	
Moisture Level:	JEDEC L-3 / 260C		JEDEC L-3 / 260C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		X6567G4NN0ZWK	X6680AZGUR	
Temp-Humidity Bias	85C/85%, 1000hrs	77	-	
Unbiased HAST	110C/85% RH, 264hrs	90	90	
Device Characterization	Test Program versus device specification	30	30	
**Storage Bake	150C, 600 Hours	77	77	
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc	90	90	
Wirebond pull	3g	77	77	
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 15 日	終了	2010 年 1 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	F761516ZAV		F761541AZVLR	
Wafer Fab:	DMOS6		DMOS6	
Wafer Technology:	1218C027.05		1218C027.06	
Assembly Site:	TIPI		TIPI	
Package Code/Pins:	ZAV/289		ZVL/354	
Mount Compound:	Hitachi 84-3MV		Hitachi 84-3MV	
Mold Compound:	Shinetsu KMC-3580LTVA		Shinetsu KMC-3580T	
Moisture Level:	JEDEC L-3 / 260C		JEDEC L-3 / 260C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		F761516ZAV	F761541AZVLR	
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc	90	90	
Wirebond pull	3g	77	77	
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C				